車載組込みシステムフォーラム(ASIF)事務局

## 第3回ASIFスキルアップセミナー開催案内

拝啓 猛暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く 御礼申し上げます。

さて、下記要領にて車載組込みシステムフォーラム(ASIF)第3回スキルアップセミナーを開催します。皆様のご参加をお待ち申し上げております。参加希望の方は、本案内の末尾にある参加申込欄に必要事項をご記入の上、FAX または郵便にて、または、同内容を記載して e-mail にて、10月21日までに、事務局までお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

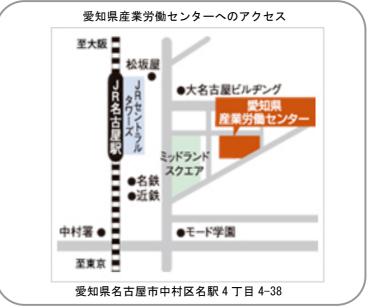
敬具

【テーマ】四大半導体メーカが語る車 載半導体の技術動向

【開催日】2009年10月28日(水)13:25 ~16:40(開場受付13:00~)

【会場】愛知県産業労働センター 10階 大会議室1001

【セミナー概要】車載半導体の今後の 技術動向について、国内半導体メ ーカより、車載電子機器に革命を もたらす最新のテクノロジーをご 紹介いただきます。



会場案内図

## 【講演内容】

13:25~13:30(5分) 開催挨拶

13:30~14:10 (40分) 「画像認識技術の紹介・取組み」

講師: NECエレクトロニクス株式会社

マイクロコンピュータ事業本部 ACEシステム事業部

ITSソリューション開発グループ グループマネジャ 肥田野 文之様

概要:1)予防安全(市場)の動向

- 2) IMAPシリーズ紹介
  - 画像認識実現のアプローチ
  - ・IMAPのアーキテクチャ・特長
  - ・プロトタイプ~第一世代~第二世代
  - ・次世代への取り組み
- 3) 開発環境
- 4) 認識機能 (ソフト)

14:10~14:15 (5分) 質疑応答

14:15~14:55 (40分)「車載マイコンの機能安全(IEC61508/ISO26262)対応の課題と取り組み」

講師:株式会社 東芝 セミコンダクター社

車載システム応用技術部 参事 高野 裕之様

概要: 車載マイコンの機能安全(IEC61508/IS026262)対応、特にハードウエア

上の課題やそのソフトウエアへの影響について解説するとともに、

東芝のARMマイコンでの取り組みについて紹介する。

14:55~15:00 (5分) 質疑応答

15:00~15:10(10分)休憩

15:10~15:50 (40分) 「情報系車載ネットワークの動向と課題解決策」

講師: 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社

基盤商品事業本部 自動車事業部 ソリューション技術部

担当部長 川西 末広 様

概要:情報系車載ネットワークの動向、および現状の課題を整理し、 その解決策として、当社の1394 Automotiveについて解説する。

15:50~15:55 (5分) 質疑応答

15:55~16:35 (40分) 「マイコンに使われるメモリの歴史とMRAMの技術動向」

講師:株式会社ルネサステクノロジ

マイコン統括本部 MCU技術開発統括部

MCU開発第一部 第三G グループマネージャ 林越 正紀 様

概要:マイコンでこれまで採用されてきたメモリの歴史を振り返りながら、

次世代マイコン用メモリとして期待されるMRAMの優れた特徴を紹介します。

16:35~16:40 (5分) 質疑応答

【受講料】ASIF会員 : 無料

ASIF非会員:3,000円 当日現金でお支払ください。領収書をお渡しします。

【申込】 参加申込フォームにご記入の上、事務局までFAXしてください。

メールの場合は、申込フォームにある内容全てを明記の上、送信してください。

申込期限:2009年 10月 21日(水)

先着順で受け付けます。期限前でも定員(150名)になり次第締め切ります。

定員超過等でお断りする場合は連絡します。

【申込先】 車載組込みシステムフォーラム (ASIF) 事務局

財団法人中部科学技術センター 産業クラスター計画支援室 山本

TEL: 052-231-3043 FAX: 052-204-1469 e-mail: monodukuri@cstc. or. jp 第3回ASIFスキルアップセミナー(2009年10月28日)参加申込フォーム

申込日	2009年 月 日	
会社名		
ASIF会員状況	会員 / 非会員 (どちらかに〇をつけてく	ださい)
氏名		
所属/役職		
連絡先	住所:〒	
	TEL: FAX:	
	e-mail (必須) :	